

PLCC-Fassungen - Einlöt-Version PLCC-Socket - Solder Type

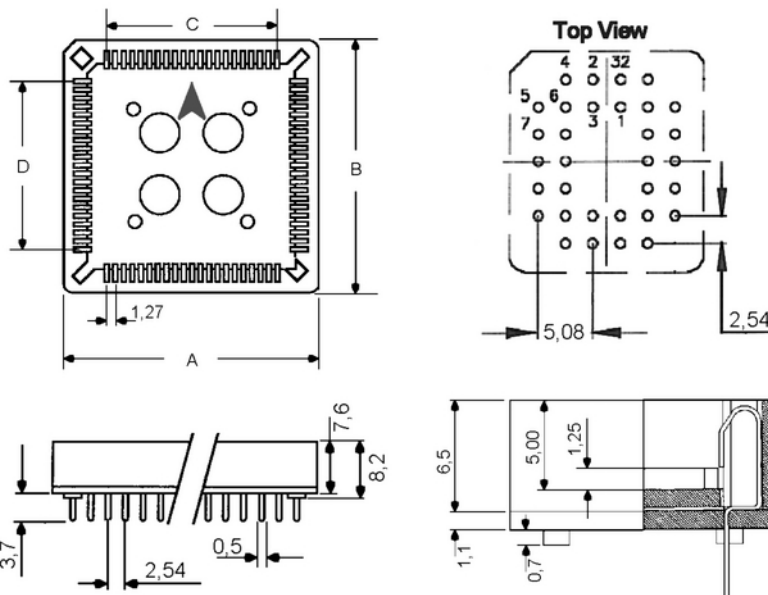
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor bronze
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 30mΩ
Contact Resistance	< 30mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit	500V _{RMS}
Test Voltage	500V _{RMS}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +105°C
Temperature Range	-55°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS

Die Chipbestückung kann erst nach dem Lötprozess erfolgen.
We strongly recommend to populate the socket after soldering.



n	A ± 0.20	B ± 0.20	C ± 0.10	D ± 0.10
20	15.56	15.56	5.08	5.08
28	18.10	18.10	7.62	7.62
32	18.10	20.64	7.62	10.16
44	23.18	23.18	12.70	12.70
52	25.72	25.72	15.24	15.24
68	30.80	30.80	20.32	20.32
84	35.88	35.88	25.40	25.40

Series

196

Contacts*

28

20/28/32/44/52/68/84

Plating

50

50 Verzinkt (Standard)
Tin plated (Standard)

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

